

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

关于 2024 年度申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、概述

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司及子公司 2024 年度计划向银行等金融机构申请总额度为人民币 4,000.00 万元的综合授信（包括不限于银行贷款、设备融资租赁、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保理、国内信用证等融资授信），授信期限为壹年，自公司及子公司与银行签订综合授信及其他相关合同之日起计算。最终授信额度以相关银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定；授权公司董事会全权代表签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。董事长朱宇、股东辽宁双宇企业管理有限责任公司为上述授信额度提供连带责任保证。

二、审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》。召开董事会时，因该议案涉及关联交易事项，关联董事朱宇回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

三、申请综合授信的必要性以及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

- （一）《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2024年4月25日